

PRODUCT-DETAILS

RD23F1

RD23F1 Roof plate w.flange openings



Ogólne informacje

Extended Product Type	RD23F1
ID Produktu	2CPX045732R9999
Numer EAN	4011617457329
Opis katalogowy	RD23F1 Roof plate w.flange openings
Opis	RD23F1 Roof plate w.flange openings

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617457329
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	610 mm
Wysokość produktu netto	12 mm
Głębokość produktu netto	325 mm
Waga produktu netto	2.171 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	325.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	610.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.258 kg
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	7035
DIN Place Units	0
Typ obudowy	RD
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	300 mm
Meter Boards	0
Typ produktu	RD
Nazwa produktu	RD23F1 Roof plate w.flange openings
Remarks	ETIM
Funkcja dodatkowa	with cable entry
Odpowiedni do	2/10RG3 2/8RG3

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
ETIM 6	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Akcesoria do obudów

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → Modular Boards - TriLine

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Obudowy rozdzielnic głównych → R

